

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2023]2号

关于召开《半导体材料术语》等5项半导体材料标准 网络工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会和工业和信息化部下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及2023年标委会工作安排，现定于2023年2月7日~8日召开半导体材料标准网络工作会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《半导体材料术语》等5项半导体材料标准进行审定、预审和讨论，具体项目见附件。请各标准项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议。各标准负责起草单位务必于2月3日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱(tc203sc2@cnsmq.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于2月6日之后在有色标准信息网(www.cnsmq.com)“标准制定工作站”栏目下载。

二、会议时间

2023年2月7日上午9:00开始。

三、会议参加方式

参会人员可在“腾讯会议”软件界面，点击“加入会议”，输入会议ID及“个人姓名-单位”，点击“加入”，参加会议。

会议 ID 见附件。

四、联系方式

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

附件：审定、预审和讨论的标准项目



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

审定、预审和讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注	会议 ID
1	国标委发[2018]60号 20181808-T-469	半导体材料术语	有研半导体材料有限公司	审定	895-7669-5375
2	国标委发[2021]12号 20210892-T-469	硅片流动图形缺陷的检测 腐蚀法	徐州鑫晶半导体科技有限公司	审定	
3	国标委发[2021]12号 20210888-T-469	碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试 共焦点微分干涉法	中国电子科技集团公司 第四十六研究所	预审	
4	国标委发[2021]41号 20214650-T-469	硅中代位碳含量的红外吸收测试方法	中国电子科技集团公司 第四十六研究所	讨论	
5	工信厅科函[2021]234号 2021-1248T-YS	锗行业绿色工厂评价要求	云南驰宏锌锗股份有限公司	预审	